

NXP, 퀄컴과 NFC 와 임베디드 보안칩(eSE) 도입 가속화 위해 협력

스마트폰 넘어 모바일, 웨어러블, 사물인터넷 기기에 NFC 도입

2015년 5월 7일 - NXP 반도체(NASDAQ:NXPI)는 퀄컴 테크놀로지(Qualcomm Technologies, Inc.)가 업계 최고의 NXP 근거리무선통신(NFC)과 임베디드 보안칩(eSE) 솔루션을 퀄컴 스냅드래곤(Qualcomm® Snapdragon™) 800, 600, 400, 200 프로세서 기반 플랫폼 전체에 통합하기로 했다고 발표했다. 퀄컴 테크놀로지는 퀄컴(Qualcomm Incorporated)의 자회사이며, 퀄컴 스냅드래곤은 퀄컴 테크놀로지의 제품이다. 이로써 스냅드래곤 기반 기기에 NFC와 eSE의 신속한 도입이 가능해져 다양한 소비자 애플리케이션의 기능을 확대할 것으로 예상된다. 새로운 레퍼런스 디자인은 NFC를 스마트폰을 넘어 홈 오토메이션, 소비자 전자제품, 자동차, 스마트 애플리케이션, PC, 웨어러블과 같은 다른 애플리케이션으로까지 확대시키고 있다.

퀄컴 테크놀로지의 부사장인 코막 콘로이(Cormac Conroy) 박사는 “보안거래에서의 NXP가 가진 전문성을 고려할 때 NXP의 NFC와 eSE 칩셋이 퀄컴 테크놀로지의 플랫폼에 추가된 것은 당연한 일”이라며, “퀄컴 테크놀로지는 오늘날 최신 기기들의 기능 향상뿐만 아니라 미래의 혁신적인 새로운 애플리케이션과 폼팩터를 가능하게 할 것”이라고 밝혔다.

스냅드래곤 플랫폼용 NXP의 NFC와 eSE 제공은 퀄컴 테크놀로지의 첨단 보안 솔루션을 보완해, 모바일 결제 및 모바일, 자동차, 사물인터넷(IoE) 분야의 디지털 인증 등과 같은 수많은 새로운 애플리케이션의 안전거래 도입을 앞당기는 데 도움이 될 것이다. 새로운 솔루션에는 최근 출시된 NXP PN66T 모듈에서 가져온 NQ220 모듈이 장착된다. NQ220은 기기에 크리덴셜을 설치하는 프로세스를 간소화시켜 서비스 제공자가 새로운 애플리케이션을 손쉽게 제공할 수 있도록 설계됐다. 이로써 모바일 지갑과 선불, 환승, 접근 통제 같은 추가적인 애플리케이션의 설계 비용과 출시시간을 크게 줄일 수 있다.

NXP 반도체의 라파엘 소토메이어(Rafael Sotomayor) 수석 부사장은 “놀라운 속도로 새로운 애플리케이션이 만들어지고 있기 때문에 NFC의 사용과 도입이 하루가 다르게 증가하고 있다. 업계 최고의 퀄컴 테크놀로지 플랫폼에 eSE와 NFC의 모든 기능을 제공하기 위한 퀄컴 테크놀로지와의 협력으로 이런 성장 잠재력이 더욱 확대될 것”이라며, “협력을 통해 각자 서로의 전문 분야에 더욱 주력할 수 있어 업계는 최소한의 노력으로 신속하게 OEM으로 설계가 가능한 최고의 강력하고 검증된 솔루션을 제공 받게 될 것”이라고 말했다.

NQ220 레퍼런스 디자인은 현재 NXP의 세일즈 채널을 통해 제공되고 있으며, 자세한 내용은 NXP 세일즈팀에게 연락하면 된다.

NXP 반도체 소개

NXP 반도체 (나스닥: NXPI)는 스마트 월드를 위한 보안 연결 솔루션을 제공한다. NXP는 고성능 혼합신호 전자 부문의 전문성을 기반으로, 커넥티드 카, 보안, 포터블 및 웨어러블, 사물인터넷 등 다양한 분야에서 혁신을 주도하고 있다. NXP는 전 세계 25개 이상의 국가에서 경영조직을 운영하고 있으며, 2014년 매출은 56억 5천만 달러이다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아 볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그 (<http://blog.naver.com/nxpkor>)에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다.